

微細デバイスから 6mm の厚ものまで対応のグリーンシートカッター

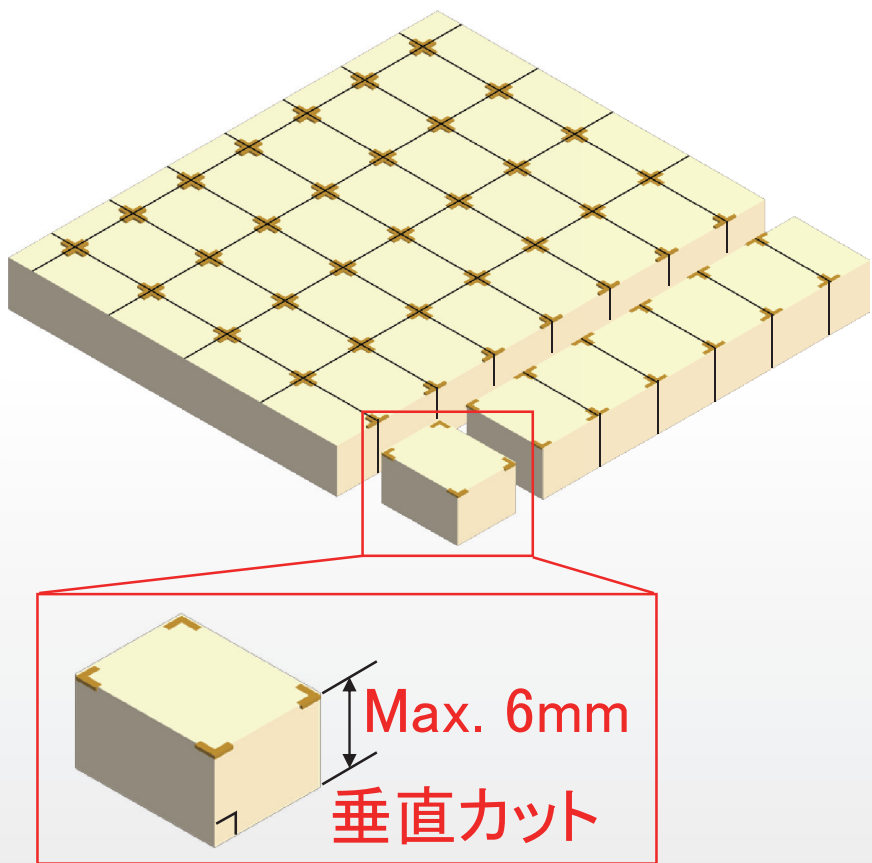
- 微細カットから厚物の垂直カットまで対応
- 弾性変形の抑制により垂直カットを実現
- 画像認識機能により部品パターンへの精密位置決め
- プロセスモニタリング機能を搭載



● 微細カットから厚物の垂直カットまで対応

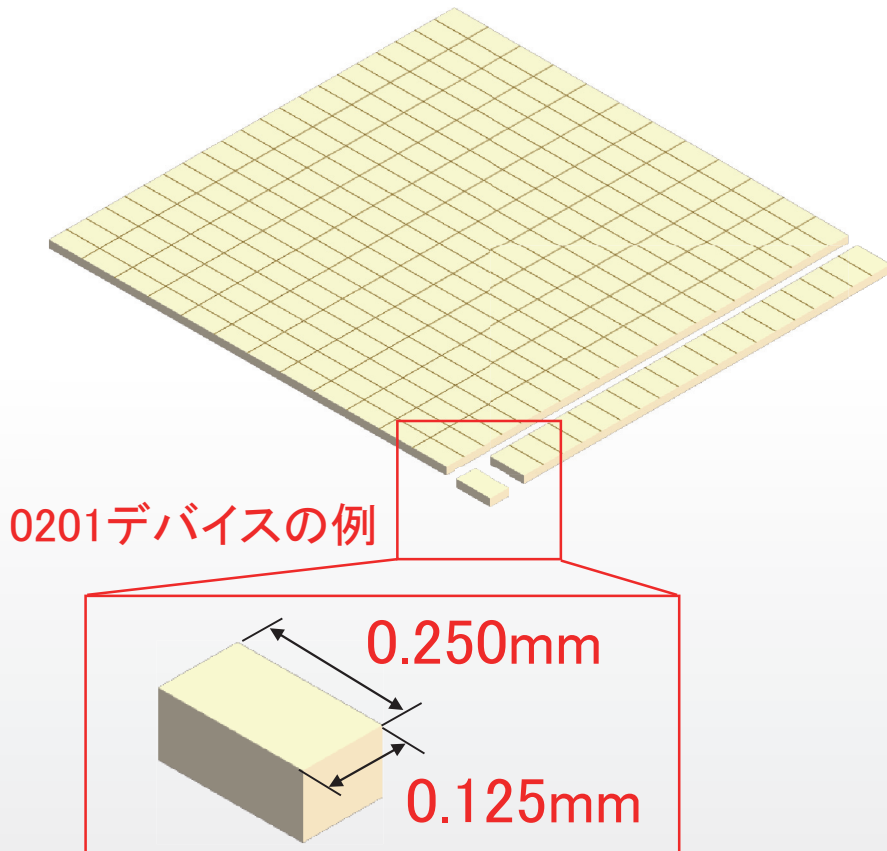
● 大容量 MLCC

デバイス大容量化への対応



● 微小 MLCC

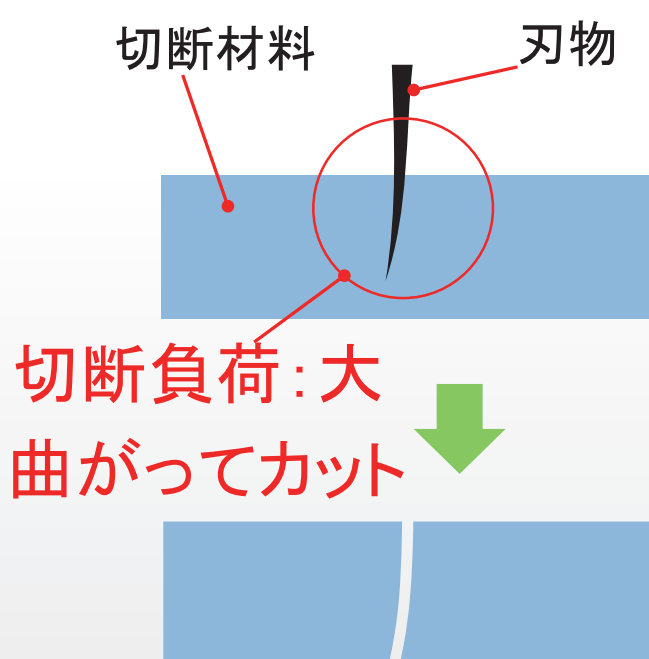
デバイスの微細化への対応



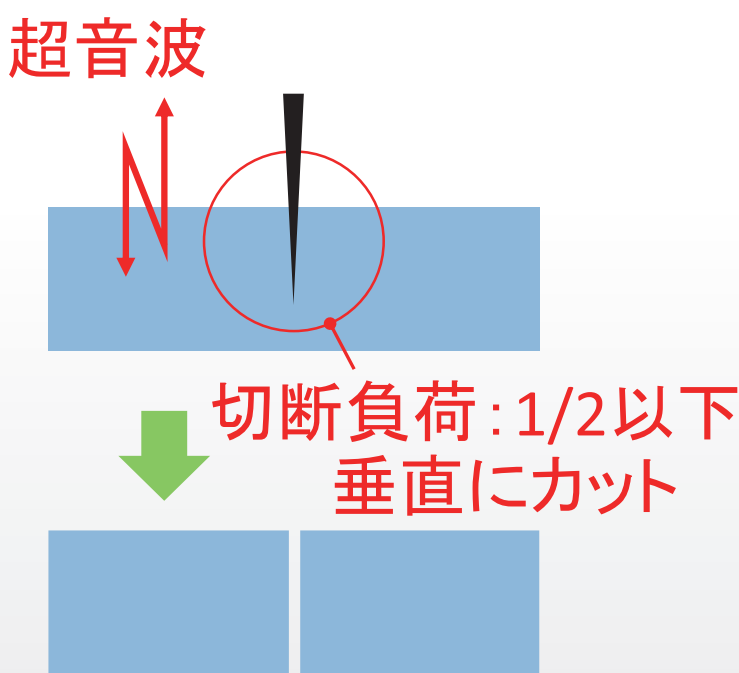
● 切断負荷の低減により垂直カットを実現

オプションの超音波アシスト機能では、刃物の切断負荷を低減でき、厚い材料の垂直カットが可能となります。

従来のカット

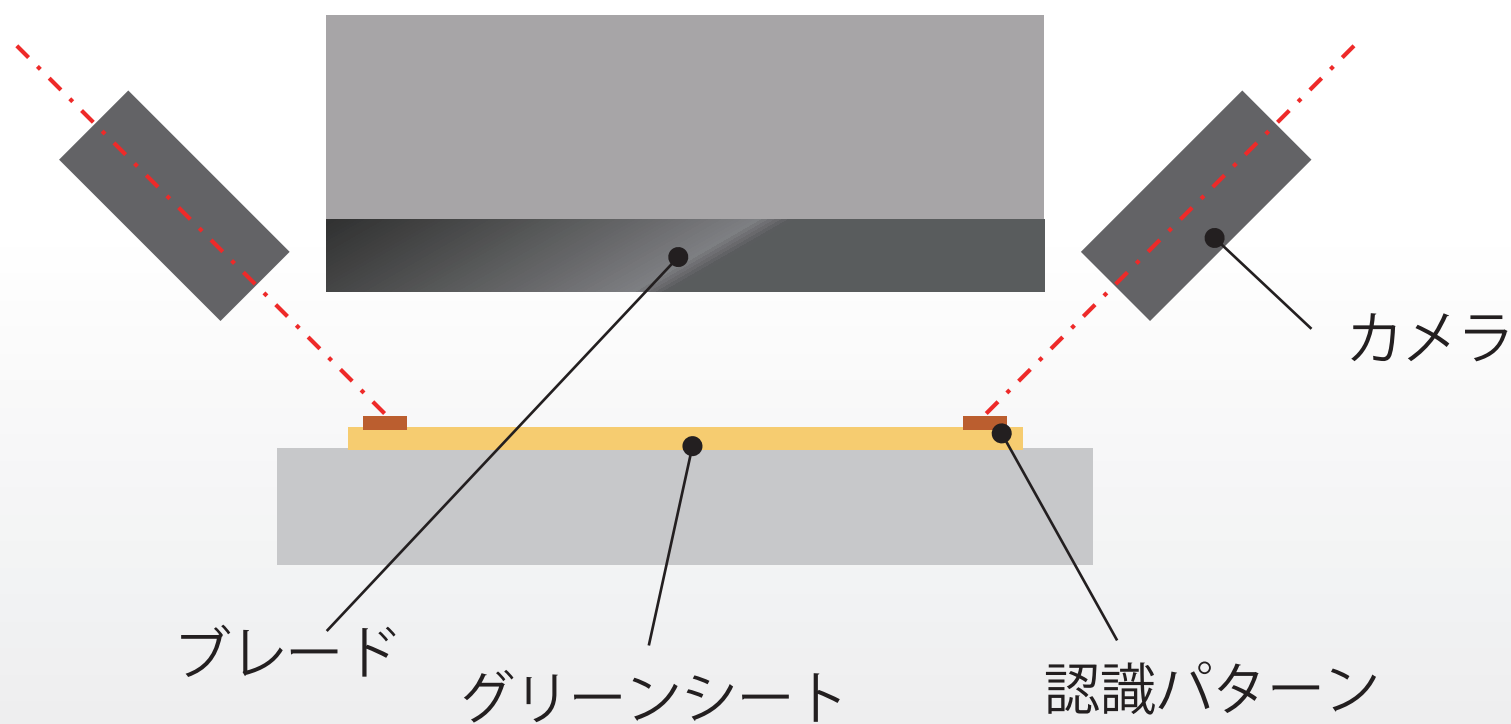


超音波カット



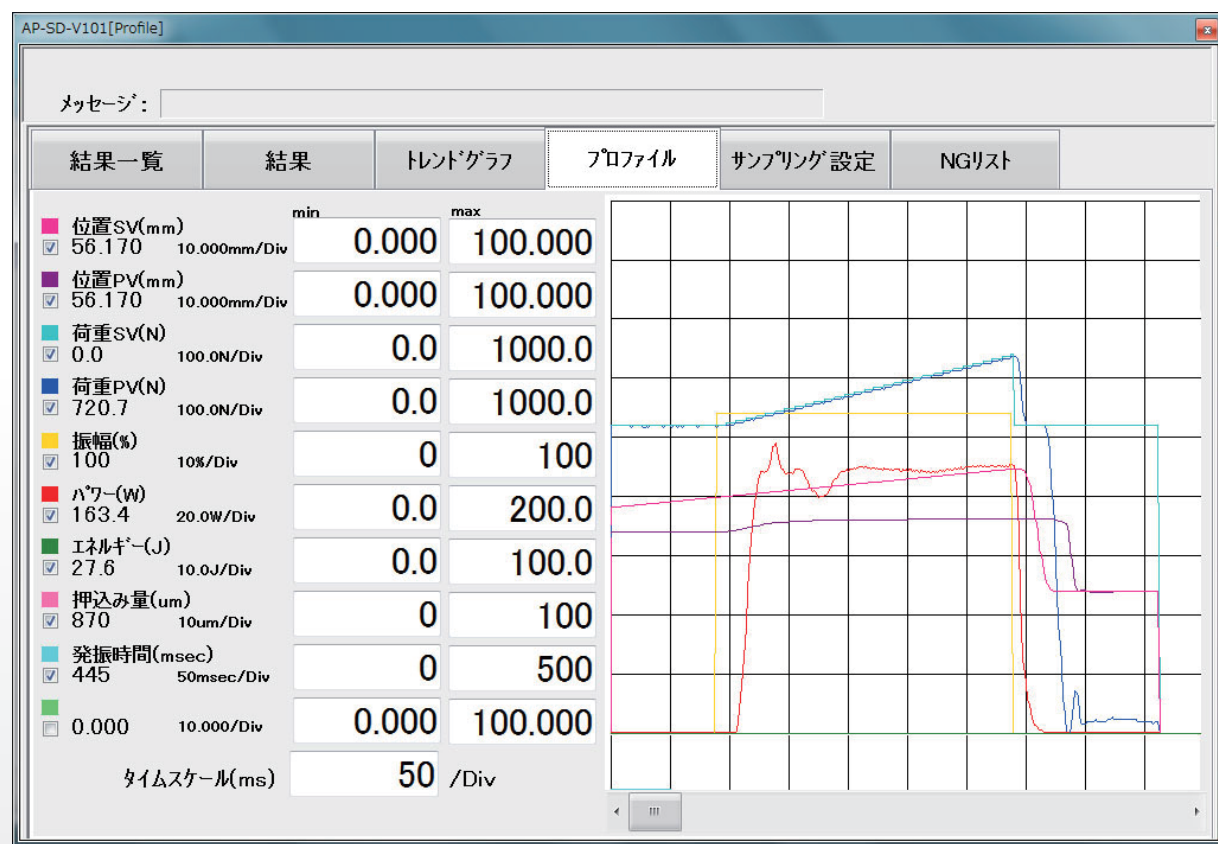
● 画像認識機能により部品パターンへの精密位置決め

グリーンシートのパターンを画像認識することで、パターンに合わせて正確な位置で切断を行うことができます。



● プロセスモニタリング機能を搭載

装置に内蔵された各種センサ情報により、プロセス動作を詳細に把握でき、プロセス立ち上げ、量産管理に有効です。



仕様 Specification

切断方式	ブレード押切カット（※オプション：超音波カット）		制御	装置制御	専用コントローラ +PLC
対象ワーク	材質	セラミックグリーンシート		操作画面	10.4" カラータッチパネル
	サイズ	最大 225mm	切断条件設定	各種切断条件をデジタル設定	
	厚さ	最大 6mm	プロセスモニタリング	プロセス中の各種データをモニタリングし、管理	
	アライメントマーク	上面 / 側面	ユーティリティ	空圧源	0.5MPa ドライエアー
精度	位置決め精度	±5μm（ヘッド軸、ステージ軸）		電 源	単相 200V 30A
	カット位置精度	±15μm（画像処理時）	装置サイズ	W1100 x D1200 x H1600mm	
ワークステージ	吸着エリア□200mm、加熱機能付（RT~100℃）		装置重量	1000kg	
画像認識	カメラ 2 台（45° ～ 60° 斜視）でアライメントマーク認識				
	2 値化画像重心抽出またはパターンマッチング				
ストリッパー	切断時のワーク押さえ機能				
クリーナー	ブレード付着物の除去				